# Tecnología Electrónica Ingeniería en Electrónica

Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Córdoba

## Unidad 7 - Construcción Electrónica

- DISIPACION DE ENERGIA OBJETIVO
  - Tener en consideración los efectos de la temperatura en dispositivos que manejan y disipan potencia.
  - El aumento de la potencia a disipar trae como consecuencia la disminución de la vida útil del dispositivo si el mismo no puede transmitir ésta al ambiente.

## MODOS DE DISIPACION

#### RADIACION

- El cuerpo emite radiación electromagnética debido a su temperatura.
- La longitud de onda está entre 0,1μm a 1000 μm (espectro infrarrojo).

#### CONDUCCION

- Define la capacidad de los cuerpos a conducir calor.
- Se puede establecer la Resistencia Térmica, que es la oposición al paso de calor.

#### CONVECCION

 Se produce transferencia de calor debido a la interacción de un fluido que trasporta el calor entre zonas de diferente temperatura.

## DISIPACION DE ENERGIA

#### RADIACION

$$q = \varepsilon * \sigma * A * T^4$$

 $\varepsilon$  = coeficiente de emisividad del cuerpo  $\rightarrow$  1 para cuerpo negro

$$\sigma = 5.667 \times 10^{-8} \left[ \frac{W}{m^2 K^4} \right]$$

 $A = area efectiva de transferencia de calor [ <math>m^2$  ]

T = temperatura del medio sólido [K]

## DISIPACION DE ENERGIA

#### CONDUCCION

$$q = -kA \frac{\Delta t}{\Delta x}$$

 $k = \text{conductividad termicadel medio} \left[ \frac{W}{m * {}^{\circ}C} \right]$ 

A = areaefectivade transferencia de calor  $\begin{bmatrix} -1 \\ m^2 \end{bmatrix}$ 

 $\Delta t = diferenciade temperatura entre dos puntos [°C]$ 

 $\Delta x = \text{distancia del caminotérmico [m]}$ 

## DISIPACION DE ENERGIA

#### CONVECCION

$$q = hA(t_S - t_m)$$

h = coeficiente de transferencia termicadel medio  $\left[ \frac{W}{m^2 * {}^{\circ}C} \right]$ 

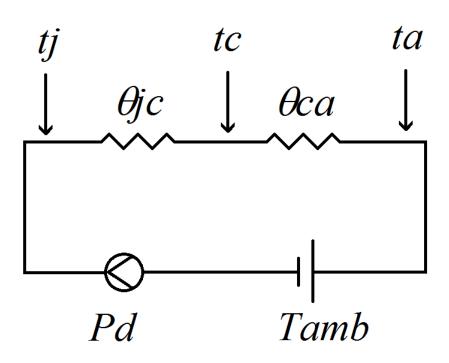
A = areaefectivade transferencia de calor  $[m^2]$ 

 $t_s = temperatum del mediosólido [°C]$ 

 $t_m = \text{temperatur del fluido } [^{\circ}C]$ 

### MODELO TERMICO SIMPLIFICADO

### **SIN DISIPADOR**



tj → temperatura juntura

tc → temperatura carcasa

ta → temperatura ambiente

Pd → potencia a disipar

Tamb → temperatura ambiente

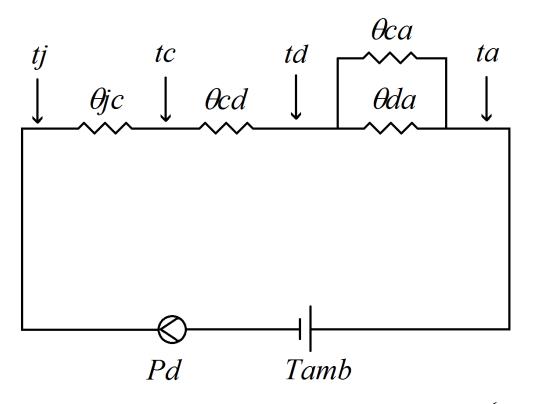
Ojc→ resistencia térmica juntura carcasa

Oca→ resistencia térmica carcasa ambiente

$$tj = Pd(\theta jc + \theta ca) + ta$$

### MODELO TERMICO SIMPLIFICADO

### CON DISIPADOR



tj → temperatura juntura tc → temperatura carcasa

td → temperatura disipador

ta → temperatura ambiente

Pd → potencia a disipar

Tamb → temperatura ambiente

Θjc→ resistencia térmica juntura carcasa

Ocd→ resistencia térmica carcasa disipador

Oca→ resistencia térmica carcasa ambiente

Oda→ resistencia térmica disipador ambiente

$$tj = Pd \left( \theta jc + \theta cd + \left( \frac{\theta ca * \theta da}{\theta ca + \theta da} \right) \right) + ta$$

## **VALORES TIPICOS**

MONTAJE	RESISTENCIA TÉRMICA θcd
DIRECTO SOBRE DISIPADOR	0.5 – 1 °C/W
AISLANTE MICA SIN GRASA	1.5 – 2 °C/W
AISLANTE MICA CON GRASA SILICONADA	1 – 1.5 °C/W

## VALORES TIPICOS – TO-3



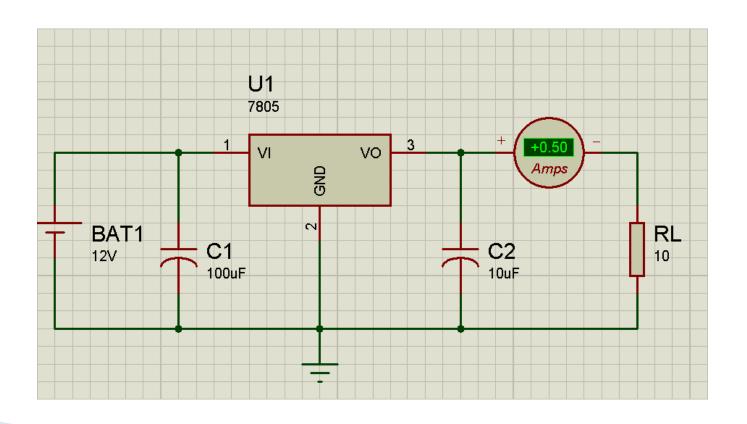
MONTAJE	RESISTENCIA TÉRMICA θcd
DIRECTO	0.25 °C/W
DIRECTO + GRASA	0.12 °C/W
DIRECTO + MICA	0.8 °C/W
DIRECTO + MICA + GRASA	0.4 °C/W

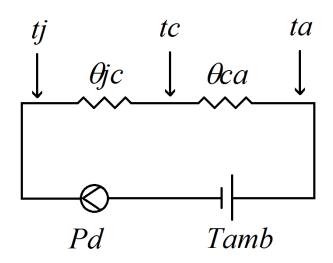
EL EMPLEO DE GRASA SILICONADA MEJORA LA CONDICIONES AL USAR MICA AISLANTE

## VALORES TIPICOS DISIPADORES



Potencia que disipa LM7805





**VIN: 12V** 

**VOUT: 5V** 

**IOUT**: 0,5A

**Especificaciones del LM7805** 

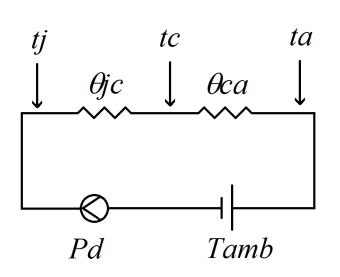
 $\Theta$ jc $\rightarrow$  5 °C/W

Θja→ 65 °C/W

#### **Absolute Maximum Ratings**

Stresses exceeding the absolute maximum ratings may damage the device. The device may not function or be operable above the recommended operating conditions and stressing the parts to these levels is not recommended. In addition, extended exposure to stresses above the recommended operating conditions may affect device reliability. The absolute maximum ratings are stress ratings only. Values are at  $T_A = 25$ °C unless otherwise noted.

Symbol	Parameter		Value	Unit
\/	V <sub>I</sub> Input Voltage	V <sub>O</sub> = 5 V to 18 V	35	V
٧١		V <sub>O</sub> = 24 V	40	V
$R_{\theta JC}$	Thermal Resistance, Junction-Case (TO-220)		5	°C/W
$R_{\theta JA}$	Thermal Resistance, Junction-Air (TO-220)		65	°C/W
т	T. On anation Townson to Bonne	LM78xx	-40 to +125	°c
T <sub>OPR</sub> Operating Temperature Range	LM78xxA	0 to +125		
T <sub>STG</sub>	Storage Temperature Range	•	- 65 to +150	°C



$$ta tj = Pd * (\theta jc + \theta ca) + ta$$

$$\downarrow tj = Pd * \theta ja + ta$$

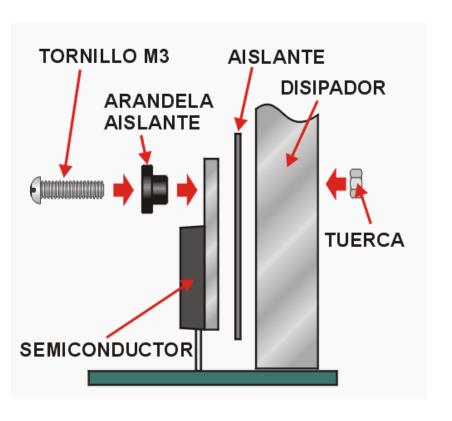
$$tj = Vd * Il * \theta ja + ta$$

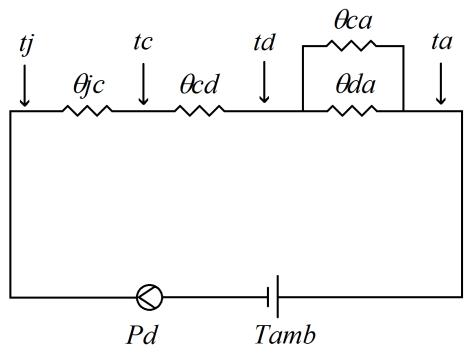
$$tj = 7V * 0.5A * 65 \frac{{}^{\circ}C}{W} + 25^{\circ}C$$

$$tj = 3.5W * 65 \frac{^{\circ}C}{W} + 25^{\circ}C = 252.5^{\circ}C$$

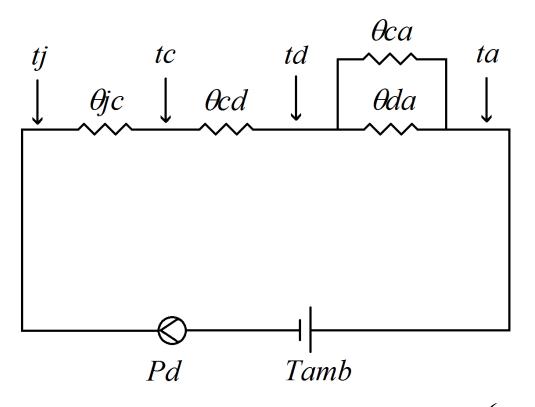
- →Supera máxima temperatura de juntura
  - $\rightarrow$  tj<=125°C
- → HACE FALTA USAR DISIPADOR

## EJEMPLO – MONTAJE





### CON DISIPADOR



tj → temperatura juntura

tc → temperatura carcasa

td → temperatura disipador

ta → temperatura ambiente

Pd → potencia a disipar

Tamb → temperatura ambiente

Ojc→ resistencia térmica juntura carcasa

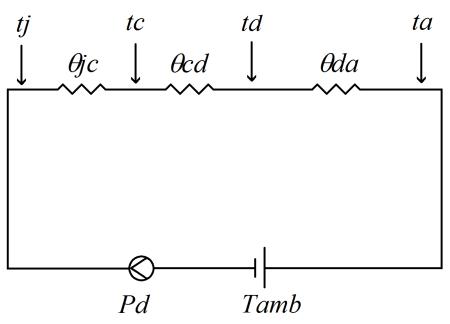
Ocd→ resistencia térmica carcasa disipador

Oca→ resistencia térmica carcasa ambiente

Oda→ resistencia térmica disipador ambiente

$$tj = Pd \left( \theta jc + \theta cd + \left( \frac{\theta ca * \theta da}{\theta ca + \theta da} \right) \right) + ta$$

### CON DISIPADOR



tj → temperatura juntura

tc → temperatura carcasa

td → temperatura disipador

ta → temperatura ambiente

Pd → potencia a disipar

Tamb → temperatura ambiente

Ojc→ resistencia térmica juntura carcasa

Ocd→ resistencia térmica carcasa disipador

Oda→ resistencia térmica disipador ambiente

$$tj = Pd(\theta jc + \theta cd + \theta da) + ta$$

→ Desprecio la resistencia Carcaza Ambiente

### CON DISIPADOR

$$tj = Pd * (\theta jc + \theta cd + \theta da) + ta$$

$$\theta da = \frac{tj - ta}{Pd} - \theta jc - \theta cd$$

$$\theta da = \frac{125^{\circ}C - 25^{\circ}C}{3,5W} - 5\frac{^{\circ}C}{W} - 1\frac{^{\circ}C}{W}$$

$$\theta da \le 22,57\frac{^{\circ}C}{W}$$



Artículo: 5235FD
Perfil U:20x20x20 1.5mm espesor
Altura: 20mm
Resistencia Térmica: 21° c/w

### CON DISIPADOR+MICA

$$tj = Pd * [\theta jc + (\theta cd + \theta ad) + \theta da] + ta$$

$$\theta da = \frac{tj - ta}{Pd} - \theta jc - (\theta cd + \theta ad)$$

$$\theta da = \frac{125^{\circ}C - 25^{\circ}C}{3,5W} - 5\frac{^{\circ}C}{W} - 2\frac{^{\circ}C}{W}$$

$$\theta da \le 21,57\frac{^{\circ}C}{W}$$

disipador de mayor tamaño

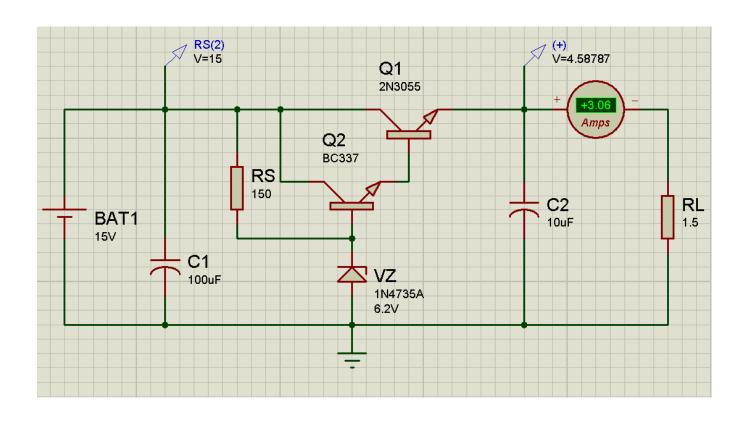


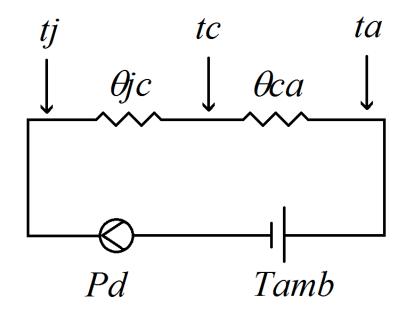
Articulo: 2725D Perfil U:29x29x29 1.5mm espesor

Altura: 40mm

Resistencia Térmica: 10° c/w

Potencia que disipa 2N3055





**VIN: 15V** 

**VOUT: 4,58V** 

IOUT: 3.06A

 $Ta = 40^{\circ}C$ 

Tj = 200°C

# EJEMPLO - Especificaciones

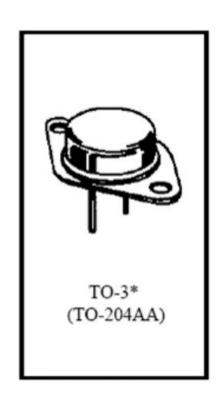
#### MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	Value	Units
Collector-Emitter Voltage	V <sub>CEO</sub>	70	Vdc
Collector-Base Voltage	V <sub>CBO</sub>	100	Vdc
Emitter-Base Voltage	V <sub>EBO</sub>	7.0	Vdc
Base Current	IB	7.0	Adc
Collector Current	Ic	15	Adc
Total Power Dissipation @ $T_A = 25^{\circ}C^{(1)}$ @ $T_C = 25^{\circ}C^{(2)}$	P <sub>T</sub>	6.0 117	W W
Operating & Storage Temperature Range	Top. Tstg	-65 to +200	°C

#### THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	ReJC	1.5	°C/W

- 1) Derate linearly @ 34.2 mW/ $^{\circ}$ C for T<sub>A</sub> > +25 $^{\circ}$ C 2) Derate linearly @ 668 mW/ $^{\circ}$ C for T<sub>C</sub> > +25 $^{\circ}$ C



#### 2N3055(NPN), MJ2955(PNP)

#### THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance, Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	1.52	°C/W

# CALCULO sin Disipador

**VIN: 15V** 

**VOUT: 4,58V** 

**IOUT**: 3.06A

 $Ta = 40^{\circ}C$ 

Tjmax = 200°C

Θjc→ 1.52 °C/W

#### **Ecuación General**

$$tj = Pd(\theta jc + \theta ca) + ta$$
$$tj = Pd * \theta ja + ta$$

#### Determino Resistencia Cápsula Ambiente

$$\theta jc = \frac{tj - ta}{P \max} = \frac{200^{\circ} C - 25^{\circ} C}{115W} = 1,52 \frac{^{\circ} C}{W}$$

$$\theta ja = \frac{tj - ta}{P \max} = \frac{200^{\circ} C - 25^{\circ} C}{6W} = 29,17 \frac{^{\circ} C}{W}$$

$$\theta ca = \theta ja - \theta jc = 29,17 \frac{^{\circ} C}{W} - 1,52 \frac{^{\circ} C}{W}$$

$$\theta ca = 27,65 \frac{^{\circ} C}{W}$$

#### Determino Tj con datos de ejemplo

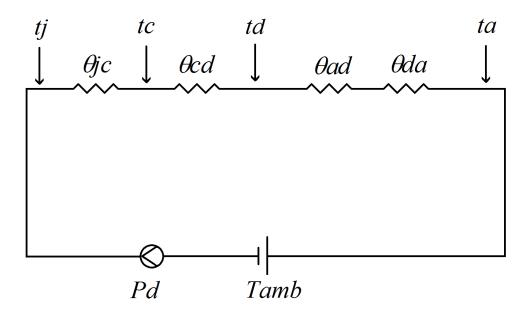
$$tj = Pd * \theta ja + ta$$

$$tj = (Vin - Vl) * Iout * \theta ja + ta$$

$$tj = (15V - 4,58V) * 3,06A * 29,17 \frac{^{\circ}C}{W} + 40^{\circ}C$$

$$tj = 970,09^{\circ}C$$

### ► CON DISIPADOR + MICA



tj → temperatura juntura tc → temperatura carcasa td → temperatura disipador ta → temperatura ambiente

Pd → potencia a disipar

Tamb → temperatura ambiente

Ojc→ resistencia térmica juntura carcasa

Ocd→ resistencia térmica carcasa disipador

Θad→ resistencia térmica aislante disipador (MICA)

Oda→ resistencia térmica disipador ambiente

$$tj = Pd(\theta jc + \theta ca_{islante} + \theta ad + \theta da) + ta$$

#### CON DISIPADOR + MICA

$$tj = Pd(\theta jc + \theta cd + \theta da) + ta$$

$$200^{\circ}C = 31,88W \left(1,52\frac{{}^{\circ}C}{W} + 0,4\frac{{}^{\circ}C}{W} + \theta da\right) + 40^{\circ}C$$

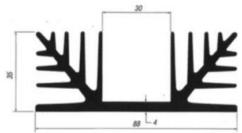
$$\theta da = 3,09 \frac{^{\circ}C}{W} \rightarrow tj = 200 ^{\circ}C$$

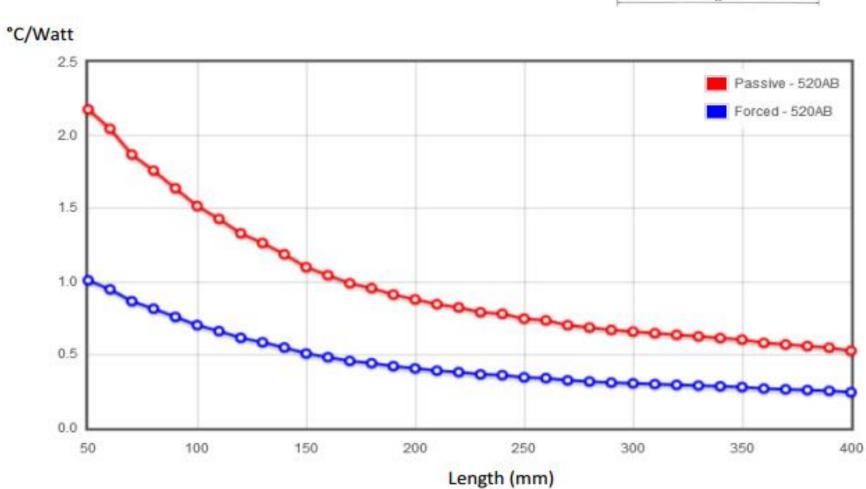
$$\theta da = 1,53 \frac{^{\circ} C}{W} \rightarrow tj = 150 ^{\circ} C$$

Podríamos usar un disipador ABL 520AB de largo 100mm

Podría usar un disipador ABL 520AB de largo 100mm

#### 520AB





# Bibliografía

http://materias.fi.uba.ar/6625/Clases/Dispositivos%20de%20Potencia.pdf
http://www.farnell.com/datasheets/2034697.pdf
http://www.fra.utn.edu.ar/download/carreras/ingenierias/electrica/materias/
planestudio/quintonivel/electronicall/hojas\_datos/disipadores/catalogo.pd
f

http://www.wakefield-vette.com/products/catalog.aspx